

整合报告

报告编号:SHR09032630303001C

第 1 页 共 13 页

申请单位 :亮群电子(常熟)有限公司
地 址 :江苏常熟经济开发区高新技术产业园宁波路 88 号

整合样品信息:

样品名称 :温控开关
样品型号 :T23/T24/T26/T36 系列
样品料号 :/
样品数量 :/
客户 :/
收样日期 :2009.03.26
完成日期 :2009.03.26-2009.04.03
整合依据 :根据客户要求将其提供之部品测试报告进行整合,客户对其提供报告真实性及有效性负责。

结论 :合格

根据客户提供的测试报告的结果显示,所有结果均低于欧盟 RoHS 指令 2002/95/EC 的修订指令 2005/618/EC 要求的限值。

主 检:

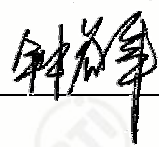


签 发:



技术经理

审 核:



签发日期:

2009.04.03

目录

部品编号	3
样品信息	4
样品测试结果	5
样品照片	7
附页(豁免项)	8

以下测试报告除标明 CTI 外, 皆为其它第三方检测机构出具:

序号	报告编号	报告出具日期	申请单位
CTI			
1	RLSHB000036570001	2009.02.13	昆山市锦龙电器有限公司
2	SHR09040230301001	2009.04.03	扬州成春电器有限公司
3	SHR09032630302001	2009.03.31	亮群电子(常熟)有限公司
其它第三方检测机构			
4	CANEC0802990401	2008.06.14	NEW SUNSHINE METAL PLASTIC PRODUCTIONS CO., LTD.
5	CANEC0803196401	2008.06.24	DONGGUAN XIN FA METAL MATERIALS CO., LTD.
6	SH8122857/CHEM	2008.08.27	NING BO POWERWAY NONFERROUS ALLOY BAR CO., LTD.
7.1	EC408356600	2008.08.07	NEOMAX MATERIALS CO LTD
7.2	EC408356400	2008.08.07	NEOMAX MATERIALS CO LTD
8.1	10127354/08(9)	2008.06.10	CHEVRON PHILLIPS CHEMICALS ASIA PTE LTD.
8.2	10127354/08(8)	2008.06.10	CHEVRON PHILLIPS CHEMICALS ASIA PTE LTD.
9	CE/2008/B3672	2008.11.20	长春人造树脂股份有限公司
10	GZ0810147260/CHEM	2008.10.21	FIRST ELECTRIC CONTACTS CORP.(DONGGUAN)
11	CANEC0806280601	2008.11.21	东莞市大朗源亿电子五金制品厂
12	CANEC0807044904	2009.01.05	东莞市大朗亚菲达金属加工厂
13	CANEC0802583304	2008.05.28	DONGGUAN YIHAI ELECTROPLATING FACTORY
14	CANEC0805461501	2008.10.13	BRISTRIP LIMITED
15	CANEC0802583302	2008.05.28	DONGGUAN YIHAI ELECTROPLATING FACTORY
16	CE/2008/B5384	2008.12.01	钛贸科技股份有限公司
17	SH8145666/CHEM	2008.10.13	浙江卓达铜业有限公司
18	WUX0609984	2008.09.04	KUNSHAN TRUETIME COMPLEX MATERIAL CO., LTD.
19	CANEC0803270701	2008.06.27	SHENZHEN JUFENG SOLDER CO., LTD

根据客户提供的报告, 有关部品数据总结如下:

序号	样品名称	整合部品名称	材料	型号
1	瓷推杆(顶杆)	顶针	氧化铝瓷	φ 1.9×7
2	陶瓷	内支架、本体	95% Al ₂ O ₃	/
3	双金属	圆片	/	/
4	AL	上盖	/	/
5	STAINLESS STEEL	上盖、支架	/	/
6	FREE-CUTTING BRASS	上盖	Cu Pb Zn	C3602
7.1	BI METAL	圆片	/	/
7.2	BI METAL	圆片	/	/
8.1	Plastic PPS resin (brown)	内支架、本体、复位按钮	/	/
8.2	Plastic PPS resin (brown)	内支架、本体、复位按钮	/	/
9	T373J / T385J / T383J / T383JC01 / T33 / T365 / T614 / T308J / T359J / T33J / T377J / T378J / T377 JA / T375J / T375HF / T376J / T355J / T357 / T310 / T399J / T391 / T651 / T200NA / T200HF / T220NA	内支架、本体	/	PHENOLIC MOLDING COMPOUND
10	AgNi Wire	银点 F、银点 R	/	/
11	铜材	铆钉、手动铆钉	/	/
12	SWRM10	铆钉、手动铆钉	/	/
13	镀雾锡	端子脚、端子 A、端子 J	/	/
14	CU C2680	端子脚、端子	/	/
15	镀镍	端子脚、支架	/	/
16	铍铜	跳板	/	C174
17	管状铆钉	套管	铜+锌	φ 2.0×0.3×17
18	BLACK VISCOUS MATERIAL	胶	/	/
19	LEAD-FREE SOLDER WIRE	焊锡	/	/

序号	样品描述	测试项目(单位: mg/kg)						结论
		Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	
1	白色陶瓷	25	<2	<2	<2	<5	<5	合格
2	白色陶瓷	<2	<2	<2	<2	/	/	合格
3	有印字的银灰色金属	<2	<2	<2	Negative	/	/	合格
4	Silvery metal sheet	16	<2	<2	Negative	/	/	合格
5	Silvery metal sheet	<2	<2	<2	Negative	<5	<5	合格
6	Yellow-copper metal bar	28109*	2	<2	Negative	/	/	合格
7.1	Silvery Metal w/ Dark Blue Printing	<2	<2	<2	Negative	<5	<5	合格
7.2	Silvery Metal w/ Black Printing	<2	<2	<2	Negative	<5	<5	合格
8.1	Plastic PPS resin (brown)	<2	<2	<2	<2	<5	<5	合格
8.2	Plastic PPS resin (brown)	<2	<2	<2	<2	<5	<5	合格
9	黑色细粒	<2	<2	<2	<2	<5	<5	合格
10	Silvery metal wire	<2	6	<2	Negative	/	/	合格
11	铜色金属线	<2	<2	<2	Negative	/	/	合格
12	带深灰色表层的金属	<2	<2	<2	Negative	/	/	合格
13	Silvery plated metal	40	<2	<2	Negative	/	/	合格
14	Brassy metal	23	<2	<2	Negative	/	/	合格
限值	Pb ≤1000 mg/kg Cd≤100 mg/kg Hg≤1000 mg/kg Cr(VI)≤1000 mg/kg PBBs≤1000 mg/kg PBDEs≤1000 mg/kg							

序号	样品描述	测试项目(单位: mg/kg)						结论
		Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	
15	Silvery plated metal	<2	<2	<2	Negative	/	/	合格
16	铜色金属	<2	<2	<2	Negative	<5	<5	合格
17	黄色金属	122	<2	<2	Negative	/	/	合格
18	BLACK VISCOUS MATERIAL	<2	<2	<2	<1	<5	<5	合格
19	Silvery metal wire	88	<2	<2	Negative	<5	<5	合格
限值	Pb ≤1000 mg/kg Cd≤100 mg/kg Hg≤1000 mg/kg Cr(VI)≤1000 mg/kg PBBs≤1000 mg/kg PBDEs≤1000 mg/kg							

注 : -mg/kg=ppm=百万分之几.

Negative 表示阴性(不含有 Cr(VI))

*样品涉及欧盟 RoHS 豁免项第 6 条: 铅作为合金元素在铜合金里,铅的重量含量不超过 4%。

报告编号末尾中“C”表示此报告为中文版本.

1. 整合报告不可等同于测试报告
2. 整合报告的数据来源于客户所提供的测试报告, 申请者承担因整合报告而引起的法律责任。
3. 如果此声明与 CTI 其他条款有任何不等或冲突, 应以此声明为准。

样品照片



*** 报告结束 ***

本报告无 CTI 盖章无效。本报告不得修改、增加或删除。此结果只对本次受测样品的结果负责。未经 CTI 书面同意，不得部分复制本报告，亦不可作为宣传品使用。

上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路 999 号 15-3#栋四楼

RoHS指令豁免项目

Exempted Items of RoHS Directive

欧盟委员会针对豁免材料陆续发布了 8 次决议，分别是：2002/95/EC、2005/717/EC、2005/747/EC、2006/310/EC、2006/690/EC、2006/691/EC、2006/692/EC 和 2008/385/EC，这些决议中的豁免共计 32 项：

The Commission of the European Communities have issued eight commission decision about the exemptions. They are 2002/95/EC、2005/717/EC、2005/747/EC、2006/310/EC、2006/690/EC、2006/691/EC、2006/692/EC and 2008/385/EC. There are 32 exemption items altogether.

1. Mercury in compact fluorescent lamps not exceeding 5 mg per lamp.
小型荧光灯中的汞，汞含量不超过 5mg/灯。
2. Mercury in straight fluorescent lamps for general purposes not exceeding:
普通用途直荧光灯中的汞，汞含量不超过：
 - Halophosphate 10 mg;
盐磷酸盐 10mg.
 - Triphosphate with normal lifetime 5 mg;
普通寿命的三磷酸盐 5mg
 - Triphosphate with long lifetime 8 mg.
长寿命的三磷酸盐 8mg
3. Mercury in straight fluorescent lamps for special purposes.
特殊用途直荧光灯中的汞
4. Mercury in other lamps not specifically mentioned in this Annex.
本附录未明确提出的其他灯具中的汞
5. Lead in glass of cathode ray tubes, electronic components and fluorescent tubes.
阴极射线管，电子元件以及荧光管的玻璃中的铅

RoHS指令豁免项目

Exempted Items of RoHS Directive

6. Lead as an alloying element in:
铅作为合金元素在:
 - Steel containing up to 0.35 % lead by weight;
钢里, 铅的重量含量不超过 0.35 %
 - Aluminium containing up to 0.4 % lead by weight;
铝里, 铅的重量含量不超过 0.4%
 - Copper alloy containing up to 4 % lead by weight.
铜合金里, 铅的重量含量不超过 4%
7. Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85 % by weight or more lead).
用于高温融化焊料中的铅 (即: 锡铅焊料合金中铅含量超过 85%)
Lead in solders for servers, storage and storage array systems, network infrastructure equipment for switching, signalling, transmission as well as network management for telecommunication.
用于服务器, 存储器和存储系统中的铅, 用于交换, 信号和传输, 以及电信网络管理的网络基础设施设备中焊料中的铅。
Lead in electronic ceramic parts (e.g. piezoelectric devices).
电子陶瓷产品中的铅 (如: 高压电子装置)
8. Cadmium and its compounds in electrical contacts and cadmium plating except for applications banned under Directive 91/338/EEC amending Directive 76/769/EEC relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations.
根据修改关于限制特定危险物质和与制品销售和使用的第 76/769/EEC 号指令的 91/338/EEC 号指令禁止以外的电气触点和镉电镀。
9. Hexavalent chromium as an anti-corrosion of the carbon steel cooling system in absorption refrigerators.
在吸收式电冰箱中作为碳钢冷却系统防腐剂的六价铬。

RoHS指令豁免项目

Exempted Items of RoHS Directive

10. Lead in lead-bronze bearing shells and bushes.
用于铅铜合金轴承和衬套中的铅。
11. Lead used in compliant pin connector systems.
顺应针连接器系统中的铅。
12. Lead as a coating material for the thermal conduction module c-ring.
用于热传导模块 C-环的被覆材料中的铅。
13. Lead and cadmium in optical and filter glass.
用于光学及滤波器玻璃中的铅和镉。
14. Lead in solders consisting of more than two elements for the connection between the pins and the package of microprocessors with a lead content of more than 80% and less than 85% by weight.
微处理器引脚及封装联接所使用的含两种以上组分的焊料中的铅（铅含量在 80% 与 85% 之间）。
15. Lead in solders to complete a viable electrical connection between semiconductor die and carrier within integrated circuit Flip Chip packages.
集成电路倒装芯片封装中半导体芯片及载体之间形成可靠联接所用焊料中的铅。
16. Lead in linear incandescent lamps with silicate coated tubes.
用于带有硅酸盐灯管的线型白炽灯中的铅。
17. Lead halide as radiant agent in High Intensity Discharge (HID) lamps used for professional reprography applications.
用在专业复印领域高强度放电灯(HID)做激发介质中的卤素铅。
18. Lead as activator in the fluorescent powder (1 % lead by weight or less) of discharge lamps when used as sun tanning lamps containing phosphors such as BSP (BaSi2O5:Pb) as well as when used as speciality lamps for diazo-printing reprography, lithography, insect traps, photochemical and curing processes containing phosphors such as SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb).
放电管的荧光粉中作为催化剂的铅（铅的重量小于等于 1%）可以豁免，当放电管用于含有磷元素（如 BSP (BaSi2O5:Pb)）的日晒灯时，以及用于重氮印刷、平板印刷、捕虫、光化学、固化工艺等等专业领域的灯具时。

RoHS指令豁免项目

Exempted Items of RoHS Directive

19. Lead with PbBiSn-Hg and PbInSn-Hg in specific compositions as main amalgam and with PbSn-Hg as auxiliary amalgam in very compact Energy Saving Lamps (ESL).
小型节能灯中作为主要汞合金的特定的 PbBiSn-Hg 和 PbInSn-Hg 中的铅, 以及作为辅助汞合金的 PbSn-Hg 中的铅。
20. Lead oxide in glass used for bonding front and rear substrates of flat fluorescent lamps used for Liquid Crystal Displays (LCD).
LCD 的平板荧光灯前后基板键合时所用玻璃中的铅。
21. Lead and cadmium in printing inks for the application of enamels on borosilicate glass.
用在硅硼玻璃表面瓷釉上的印刷油墨中的铅和镉;
22. Lead as impurity in RIG (rare earth iron garnet) Faraday rotators used for fibre optic communications systems.
在光纤通讯系统中的稀土铁石榴石法拉第旋转器中的杂质铅;
23. Lead in finishes of fine pitch components other than connectors with a pitch of 0.65 mm or less with NiFe lead frames and lead in finishes of fine pitch components other than connectors with a pitch of 0.65 mm or less with copper lead frames.
小螺距零部件表面处理中的铅 (螺距不超过 0.65mm 且带镍铁边框的连接器的连接器, 以及螺距不超过 0.65mm 且带铜边框的连接器的连接器不在豁免之内)
24. Lead in solders for the soldering to machined through hole discoidal and planar array ceramic multilayer capacitors.
通过盘状及平面阵列陶瓷多层电容器的焊料所含的铅;

RoHS指令豁免项目

Exempted Items of RoHS Directive

25. Lead oxide in plasma display panels (PDP) and surface conduction electron emitter displays (SED) used in structural elements; notably in the front and rear glass dielectric layer, the bus electrode, the black stripe, the address electrode, the barrier ribs, the seal frit and frit ring as well as in print pastes.
等离子显示屏 (PDP) 及表面传导式电子发射显示器 (SED) 构件中所用的氧化铅, 特别是在玻璃前后绝缘层中所用的氧化铅、总线电极中的氧化铅、黑条 (彩色显像管) 中的氧化铅、地址电极中的氧化铅、阻挡层肋柱的氧化铅、密封玻璃料中的氧化铅, 以及封装玻璃中的氧化铅、环状玻璃中的氧化铅、油墨中的氧化铅;
26. Lead oxide in the glass envelope of Black Light Blue (BLB) lamps.
黑光灯 (BLB) 玻璃封装中的氧化铅;
27. Lead alloys as solder for transducers used in high-powered (designated to operate for several hours at acoustic power levels of 125 dB SPL and above) loudspeakers.
用作大功率扬声器 (用在长时间操作 125 分贝以上的音响系统) 的传感器中焊料的铅合金。
29. Lead bound in crystal glass as defined in Annex I (Categories 1, 2, 3 and 4) of Council Directive 69/493/EEC (*).
水晶玻璃中铅含量的限定依照欧盟指令 69/493/EEC 附件 I (第 1、2、3、4 类)。
30. Cadmium alloys as electrical/mechanical solder joints to electrical conductors located directly on the voice coil in transducers used in high-powered loudspeakers with sound pressure levels of 100 dB (A) and more.
用于位于音压级 (SPL) 大于或等于 100 分贝的大功率扬声器音圈上的电导体的电气/机械 Welding spot 的镉合金。
31. Lead in soldering materials in mercury free flat fluorescent lamps (which e. g. are used for liquid crystal displays, design or industrial lighting).
用于无汞平板荧光灯 (例如: 用于液晶显示器、设计或工业照明) 的焊料中的铅。

RoHS指令豁免项目

Exempted Items of RoHS Directive

32. Lead oxide in seal frit used for making window assemblies for Argon and Krypton Laser tubes.

用于氩和氪激光管防护窗组合件的封装玻璃料里的铅的氧化物。

注:

- 1: 依照欧盟决议 2006/692/EC, 第 28 条豁免项目将在 2007 年 7 月 1 日中止。原第 28 条项目为: 用于防腐或屏蔽电磁干扰, 用在特定仪器设备中 (欧盟指令 2002/96/EC 第三类规定的 IT 和通讯设备) 的金属片或金属扣件上的防腐涂层中的六价铬。

According to the commission decision 2006/692/EC of the European communities, the 28th exemption item of Directive 2002/95/EC had been terminated. The 28th exemption item of Directive 2002/96/EC said:

“ Hexavalent chromium in corrosion preventive coatings of unpainted metal sheeting and fasteners used for corrosion protection and Electromagnetic Interference shielding in equipment falling under category three of Directive 2002/96/EC. Exemption granted until 1 July 2007” .

- 2: 2008 年 4 月 1 日, 欧洲法院 (European Court of Justice) 发布公告: 欧盟委员会 2005 年公布的针对十溴二苯醚的豁免项目存在程序性的错误, 因此废除委员会决议 2005/717/EC 对聚合物中十溴二苯醚的豁免。

The exemption of DecaBDE in polymeric application according 2005/717/EC was overruled by the European Court of Justice by its decision of 01.04.2008.

- 3: 以上豁免项目, 若中文译文与英文原文意思上不一致, 以英文原文为准。

The above exemptions item, if the Chinese translation is inconsistent with the English meaning of the original text, the English original shall prevail.